

3

機能性ポリイミド

特徴

- 独自一次構造制御により各種機能を付与
- ワニス、フィルム、CCLへの展開が可能



01 高伸度ポリイミドフィルム 開発品

用途	ストレッチャブル用途 フレキシブルハイブリッド エレクトロニクス基板
特徴	高伸度・低応力・高耐熱の達成
	 

	高伸度ポリイミド	
	開発品①	開発品②
破断伸度 [%]	701	414
100% 伸長応力 [MPa]	2.8	5.3
耐熱性※ [°C]	140	>250

※DMA 弹性率が 1 MPa 以上保持する温度

02 低誘電・低熱膨張性ポリイミド-FCCL 開発品

用途	高速通信
高周波対応	フレキシブル 銅張積層板 (FCCL)
特徴	低誘電・低熱膨張性の両立
F Series	New (開発品)

F Series

銅箔
ポリイミド
F Series
銅箔

New (開発品)

銅箔
ポリイミド
New type
銅箔

	ESPANEX	
	F Series	開発品③※
誘電率	X-Y (SPDR) @10GHz	3.3
誘電正接	X-Y (SPDR) @10GHz	0.0031
熱膨張率 [ppm/K]	18	18
ピール強度 [kN/m]	1.2	1.2
吸水率 [%] @25°C 50%RH	0.8	0.2

※Cu=12μm, PI=75μm